

债券代码：115569.SH

债券简称：23 国联 K1

华泰联合证券有限责任公司  
关于无锡市国联发展（集团）有限公司 2023 年面向专业投资者  
公开发行科技创新公司债券（专项用于集成电路）（第一期）募  
集资金使用项目进展情况的受托管理事务临时报告

债券受托管理人  
华泰联合证券有限责任公司  
（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金  
小镇 B7 栋 401）

二零二四年十二月

## 重要声明

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制本报告的内容及信息均来源于无锡市国联发展（集团）有限公司（下称“发行人”或“公司”）提供的资料、公告等相关信息披露文件以及公开信息。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的承诺或声明。

## 一、公司债券的基本情况

- 1、债券名称：无锡市国联发展(集团)有限公司 2023 年公开发行科技创新公司债券(专项用于集成电路)(第一期)
- 2、债券简称：23 国联 K1
- 3、债券代码：115569.SH
- 4、发行规模：8 亿元
- 5、债券期限：3 年
- 6、担保情况：无担保
- 7、挂牌场所：上海证券交易所
- 8、本期债券票面利率：2.99%
- 9、起息日：2023 年 7 月 5 日
- 10、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

## 二、相关事项情况

### (一) 债券募集资金用途

23 国联 K1 募集资金扣除发行费用后拟将不少于 70%的募集资金通过直接投资、投资或设立基金等方式，专项投资于科技创新公司的股权；其余部分用于偿还到期债务。

23 国联 K1 募集资金将 6.00 亿元用于置换发行前的股权投资支出，具体如下：

单位：亿元

投资方式	投资标的	项目名称	行业领域	投资总额（注）	募集资金使用额	出资时间
现金增资	无锡锡虹联芯投资有限公司	出资华虹半导体（无锡）有限公司	集成电路、半导体	19,533.76 万美元	4.31	2022.09
现金出资	无锡锡虹国芯投资有限公司	出资华虹半导体制造（无锡）有限公司	集成电路、半导体	15,678.00 万美元	1.69	2023.03
合计					6.00	-

注：截至目前，无锡锡虹联芯投资有限公司对华虹半导体（无锡）有限公司累计投资总额 50,737.03 万美元；无锡锡虹国芯投资有限公司对华虹半导体制造（无锡）有限公司累计

投资总额 32,160.00 万美元。

投资标的基本情况如下：

1、华虹半导体（无锡）有限公司成立于 2017 年 10 月，属于重点支持的半导体和集成电路领域。

华虹半导体（无锡）有限公司主营晶圆代工业务，以打造全球领先的 90-65/55 纳米特色工艺集成电路制造平台为目标，专注于特色工艺平台的研发和升级，主要提供功率器件、嵌入式非易失性存储器、模拟与电源管理、逻辑与射频、独立式非易失性存储器等工艺的晶圆代工及配套服务。目前华虹半导体（无锡）有限公司打造了基于先进“特色 IC+Power”工艺而形成的五大特色工艺平台，成为国内领先的特色工艺代工生产线，并是全球首个提供 12 英寸功率器件代工服务的企业。同时，自主开发 65/55nm 标准工艺；同时寻求和第三方的技术合作，形成支持 12 英寸特色集成电路生产线不断升级的技术能力和知识产权保护体系。

2、华虹半导体制造（无锡）有限公司成立于 2022 年 6 月。公司为华虹宏力成员，以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主。目前项目仍处于初期，未来主要产品为嵌入式非失性存储器、模拟和电源管理芯片、逻辑和射频开关芯片和功率半导体芯片。并将完善并延展逻辑射频（含图像传感器）、存储器、模拟及电源管理和高端功率器件等工艺平台。

华虹半导体（无锡）有限公司及华虹半导体制造（无锡）有限公司均为华虹半导体有限公司（688347.SH、1347.HK）子公司。集成电路产业链分 IC 设计、晶圆代工和封装测试三个环节，华虹半导体有限公司属于中间的晶圆代工环节。华虹半导体有限公司是全球领先的特色工艺晶圆代工企业，也是行业内特色工艺平台覆盖最全面的晶圆代工企业。公司立足于先进“特色 IC+功率器件”的战略目标，以拓展特色工艺技术为基础，提供包括嵌入式/独立式非易失性存储器、功率器件、模拟与电源管理、逻辑与射频等多元化特色工艺平台的晶圆代工及配套服务。公司在半导体制造领域拥有多年的技术积累，长期坚持自主创新，不断研发并掌握了特色工艺的关键核心技术。公司的功率器件种类丰富度行业领先，拥有全球领先的深沟槽式超级结 MOSFET 以及 IGBT 技术成果。

## （二）债券募集资金使用及项目进展情况

截至 2024 年 6 月末，23 国联 K1 募集资金扣除发行费用后，已实际使用 6 亿元用于置换发行前的股权投资支出，2 亿元用于偿还到期债务。23 国联 K1 募集资金使用与募集说明书约定用途一致。

#### （1）科创项目进展情况

截至 2024 年 6 月末，华虹半导体（无锡）有限公司的 9.45 万片月产能已完全释放，IC 工艺节点覆盖 90-65/55 纳米，不仅是全球领先的 12 英寸特色工艺生产线，也是全球第一条 12 英寸功率器件代工生产线。公司将在产品结构、生产能力等方面持续提优增效，加强产品竞争力，满足市场需求。

华虹无锡集成电路研发和制造基地（二期）12 英寸产线的建设持续按计划推进，于 2024 年 8 月 22 日完成搬入 12 英寸生产线首批光刻机，12 月 10 日实现生产线建成投产。公司计划利用新生产线进行工艺平台的持续技术迭代，以满足下游各类新兴需求。

#### （2）促进科技创新发展效果

本期募集资金投向集成电路领域，集成电路产业是国家重要的战略性新兴产业，其技术水平和产业规模成为衡量一个国家综合国力的重要标志。加大对该类产业的支持力十分重要，兴建 12 英寸集成电路先进芯片生产线对于保证国家对重点行业的影响力，保障信息安全都有十分重要的促进意义。

### 三、重要事项影响情况

根据发行人公告，“23 国联 K1”募集资金用途与募集说明书约定一致，募集资金投向的科创类项目运营情况良好，具体投向为集成电路领域，其投资促使无锡市半导体产业引进了先进的生产技术和研发能力，提升地区创新能力、竞争力和综合实力，促进新技术产业化、规模化应用，推动战略性新兴产业加快发展。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于无锡市国联发展（集团）有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（专项用于集成电路）（第一期）募集资金使用项目进展情况的受托管理事务临时报告》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司

2024 年 12 月 18 日

